

**信頼性試験結果**  
**Reliability Test**

XCM526 シリーズ  
XCM526 Series

パッケージ : **USP-12B01**  
Package

RoHS対応品 RoHS Compliance

ハロゲン/アンチモンフリー Halogen & Antimony-Free

	No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	時間 Hours	試験結果 Result r/n
IC・PTR共通 IC・PTRCommon	1	高温保存 High Temperature Storage	150°C	1000	0/22
	2	温度サイクル Temperature Cycle (Gaseous)	-55°C~125°C 各30分 30min Each	100CYC.	0/22
	3	プレッシャークッカー UHAIST	125°C85%RH 2×10 <sup>5</sup> Pa	100	0/22
	4	はんだ耐熱 Resistance to Soldering Heat	85°C85%RH168h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)3times →85°C85%RH24h→reflow(150~200°C140sec/255°C30sec/260°C10sec)1time Moisture Sensitivity Level 1 Based on IPC/JEDEC J-STD-020D		0/22
	5	静電耐圧 Electric Static Discharge.	R=0Ω C=200pF ±100V以上 各端子3回 ±100V over 3times Each R=1500Ω C=100pF ±600V以上 各端子3回 ±600V over 3times Each		0/20
	6	低温保存 Low Temperature Storage	-55°C	1000	0/22
IC部 IC	7	高温バイアス High Temperature Bias	125°C VIN=16.5V FB=0.5V CE=2V	1000	0/22
	8	高温高湿バイアス Temperature Humidity Bias	85°C85%RH VIN=16.5V FB=0.5V CE=2V	1000	0/22
	9	ラッチアップ Latch-Up	R=0Ω C=200pF ±100V以上 各端子3回 ±100V over 3times Each 50mA以上 50mA over		0/5
PTR部 PTR	10	高温ドレインバイアス Temperature Drain Bias	125°C Vdss=30V	1000	0/22
	11	高温ゲートバイアス Temperature Gate Bias	125°C Vgss=20V	1000	0/22
	12	高温高湿ゲートバイアス Temperature Humidity Gate Bias	85°C85%RH Vgss=20V	1000	0/22

パッケージ代表データ

Performed with samples that represent the applicable PKG type.

No.	試験項目 Test Item	試験条件 Test Conditions	試験結果 Result r/n
1	接合強度試験 Adhesive strength test	PKG側面を10N 10秒間加圧する (EIAJ ED7403) apply a pressure of 10N on the side face of the PKG for 10sec.	0/5
2	基板反り試験 Bending Test	たわみ量 5mm 5±1s 1回/1time (EIAJ ED4702) Strain	0/5
3	はんだ付け性 Solderability	230°C10秒(プロファイル昇温法) 10s (Temperature profile method )	0/11